

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

## 湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260702

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 投资者关系<br>活动类别             | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他  |
| 参与单位名称<br>及人员姓名           | 2026年7月2日上午9:30~11:00：海富通：黄峰、吴昊、王振遨、白晓兰、王经纬、彭志远、聂宇霄、李子豪，共8名投资者及证券人员<br>2026年7月2日下午13:30~15:00：大成基金：齐炜中、王晶晶、张家旺、黄涛、杨挺、王磊、陈铭、朱倩、魏庆国、侯春燕、李煜、童若琰、柴子钰、吴天齐，鑫源晟投资：汪洋，彬元资本：陈海亮，中信保诚：孙国萌，共17名投资者及证券人员   |
| 时间                        | 2026年7月2日上午9:30~11:00，2026年7月2日下午13:30~15:00   |
| 地点                        | 公司9楼会议室  |
| 上市公司接待<br>人员姓名            | 董事长助理兼投关总监熊亚威先生  |
| 投资者<br>关系活动<br>主要内容<br>介绍 | <p><b>公司介绍：</b></p> <p>公鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，主营业务横跨半导体材料板块、锂电材料板块和打印复印关键材料板块等。现阶段，公司重点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖：半导体制造用CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，是集成电路用CMP抛光垫国内供应龙头，占据OLED新型显示材料YPI、PSPI国内供应领先地位，深度布局半导体KrF/ArF晶圆光刻胶、半导体先进封装材料等业务，新近切入新能源锂电关键功能材料领域，推动公司高速可持续发展。</p> <p><b>问1：公司潜江300吨ArF/KrF光刻胶产线今年3月投产，近期披露新增近千加仑批量订单，能否详细说明本次订单落地背后的产品核心竞争力，以及全年光刻胶商业化放量规划？</b></p> <p><b>答：</b>本次高端晶圆光刻胶新增批量订单，是下游多家头部晶圆厂对公司全流程自主产线、产品性能与交付稳定性的实质性认可。公司核心差异化优势体现在三方面：一是潜江二期为国内首条覆盖有机合成、高分子聚合、高</p> |

纯精制、光刻胶混配一体化量产产线，光刻胶树脂、光酸、高纯单体全部自研自产，金属离子、杂质管控指标对标海外一线厂商，从源头消除外部原材料供应链风险；二是产品矩阵布局完整，公司累计研发 40 余款高端晶圆光刻胶，近 30 款完成客户送样验证，目前共计 8 款 ArF、KrF 型号实现批量供货，较 2026 年一季度新增 5 款量产型号，同步研发 BARC、SOC 光刻辅材，可为下游晶圆厂提供一体化光刻耗材解决方案；三是客户定制化迭代能力突出，可根据客户端不同产线的工艺参数快速调整配方，适配多代制程需求。

放量节奏层面，2026 年上半年光刻胶整体交付规模同比稳步提升；下半年将重点推进十余款处于加仓样验证阶段产品的订单转化，逐步提升潜江 300 吨产线稼动率。中长期将依据下游晶圆扩产节奏规划后续产能安排，匹配国内高端晶圆光刻胶国产替代长期需求。

**问 2：6 月公司公告 PSPI、INK 两款材料在国内首条 G8.6 代产线批量量产交付，市场关注中大尺寸 OLED 需求爆发，公司显示材料板块中长期增长空间如何看待？**

**答：**此前全球 OLED 产能集中于 G6 代手机小尺寸产线，AI PC、高端平板、车载显示带动中大尺寸 OLED 需求快速增长，G8.6 代高世代产线成为面板厂商未来核心扩产方向，产线配套材料国产化空间广阔。

本次实现两款核心主材同步量产搭载，使公司成为国内唯一在国产 G8.6 代 AMOLED 产线同时实现 PSPI、TFE 封装墨水稳定供货的材料厂商，标志着公司显示材料正式切入高端中大尺寸赛道。产品端，公司 YPI、PSPI、封装 TFE INK 形成完整柔性显示配套矩阵；客户端已覆盖国内头部面板企业，同步配合多家面板厂商新产线前期工艺验证。

中长期看，中大尺寸 OLED 渗透率提升、国产高世代面板产线持续落地将持续拉动需求，公司将持续加大显示材料研发投入，同步逐渐扩建专用产线，持续巩固柔性显示核心材料国产龙头地位。

**问 3：公司在玻璃基板配套材料领域是否有相关布局，能否介绍相关产品情况及未来规划，该业务如何与公司现有业务形成协同？**

**答：**公司长期高度关注玻璃基板配套材料赛道，并开展前瞻性技术与产能布局。近期公司抛光垫产品成功获得板级封装领域重要客户订单，将批量进入以玻璃基板为代表的板级封装产线使用。该订单是抛光垫产品在先进封装领域的又一突破，继陆续进入 2.5D 和 3D 封装产线之后，又成功进入板级封装领域，持续为我国先进封装产业发展贡献力量。除此之外，本次潜江第三条软抛光软垫产线规划年产能 30 万片，核心针对玻璃基板 CMP 软垫与 2 米以上大尺寸抛光垫两大增量赛道布局，对应 HBM、光电共封装等行业新兴工艺需求。从客户验证进展来看，玻璃基板属于先进封装下一代高密度互连方案，对抛光材料提出了更高的技术要求。目前公司自研玻璃基板专用软抛光垫已向多家布局玻璃基板产线的头部封测、晶圆企业送样验证，工艺平坦度、划痕管控指标优异。

技术壁垒层面，一是配方体系差异化设计，针对玻璃材质优化产品结构，兼顾抛光速率与低缺陷要求；二是产线工艺壁垒，新建产线可覆盖玻璃基板

不同尺寸加工需求；三是垫液一体化协同优势，公司将逐渐同步配套玻璃基板用抛光液，为客户提供成套 CMP 耗材解决方案，缩短客户联合验证周期。

产能与中长期规划方面，公司现有两条软抛光垫产线合计年产能 50 万片，下游第三代衬底抛光需求持续增长，叠加玻璃基板新兴赛道增量，现有产能已难以覆盖中长期订单需求。本次扩产落地后，公司将作为国内少数具备玻璃基板抛光垫规模化量产能力的厂商，完善覆盖晶圆制造、化合物衬底、玻璃基板先进封装的多场景抛光垫产品矩阵，进一步巩固 CMP 耗材平台化竞争优势，充分把握先进封装发展带来的长期市场增量。

**问 4：当前 AI 算力芯片产业链持续景气，芯片制造对 CMP 耗材性能提出更高标准，公司相关高端抛光材料有无针对性研发与验证布局？**

**答：**伴随 AI 算力芯片产业链景气度提升，先进制程、高算力芯片制造环节对 CMP 抛光垫、抛光液的平整度、去除速率、缺陷控制等性能指标要求显著升级。公司基于自身 CMP 材料完整产品平台，围绕芯片配套先进制造工艺不断开展配方体系、基材结构等迭代开发，持续丰富高端 CMP 耗材产品矩阵，夯实国产化配套供给能力。公司采取分阶段、分客户梯度验证策略推进高端 CMP 耗材产业化落地：一方面面向国内布局芯片产线的晶圆制造、先进封装头部企业开展定向送样与联合开发，根据客户工艺测试反馈持续优化产品性能指标；另一方面同步配合下游客户工艺迭代节奏同步更新研发方案，持续推进多轮可靠性、量产适配性验证，逐步完成小批量测试、中试导入等各阶段流程。公司已建设配套高端 CMP 耗材的专业化产线，同步完善检测、评价试验平台，保障高端抛光材料的新品研发、批量供货需求；持续投入 CMP 材料产线扩建与工艺升级，为适配 AI 算力芯片制造的高端抛光材料后续规模化供货提供产能支撑。

**问 5：国内多家晶圆厂持续推进扩产，公司配套光刻胶产品市场拓展有哪些新进展，未来市占率提升的核心抓手是什么？**

**答：**当前国内多家晶圆厂持续加大产能扩建力度，下游国产化配套需求持续释放。公司高端晶圆光刻胶产品已形成稳定供货能力，持续面向国内多家晶圆制造、特色工艺产线开展批量导入工作。公司持续深化与现有头部晶圆客户的合作深度，同步完成多类特色工艺平台产品认证；同时持续开发新增晶圆厂客户，有序推进送样、评测、小批量试产至批量供货全流程验证，客户覆盖范围持续拓宽，光刻胶出货规模将保持稳步增长。公司依据下游产线工艺升级需求持续迭代产品配方，优化良率等核心指标，匹配不同客户工艺差异化使用要求，持续提升产品客户认可度。高端晶圆光刻胶市占率提升的核心抓手，一是持续完善全品类产品矩阵。围绕不同制程全工艺节点布局配套抛光垫、抛光液、晶圆光刻胶等产品，提升客户整体采购粘性，打造一站式国产化材料配套方案。二是持续深化头部晶圆厂深度绑定协同开发机制。紧跟扩产规划，提前对接客户新增产线、新建厂区配套需求，同步开展联合工艺开发；依托稳定批量供货表现持续扩大单客户采购份额，并持续拓宽客户群体。三是依托产能建设保障稳定交付能力。公司持续推进光刻胶专用产线扩建与产能爬坡，配套建设专业化仓储、精密检测平台，完善供应链保障体系，能够匹配下游晶圆厂扩产带来的增量订单需求，稳定供货交付周

|      |   |
|------|---|
|      | 期，夯实规模化供货优势。四是依托成本与研发迭代优势持续优化产品竞争力。公司通过持续工艺改良、核心原材料自主制备、规模化生产管控优化产品竞争力；同时依托持续稳定研发投入，针对迭代工艺持续更新产品性能。 |
| 附件清单 | 无   |
| 日期   | 2026 年 7 月 2 日  |